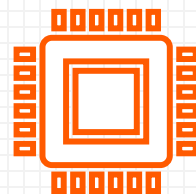


1 から つく る



半 導 体

半導体製造プロセスを2日で学べる体験実習

●参加者募集中！（理系学科不問！）

半導体って言葉を最近よく聞けどイメージがつかないし
難しそう…学んでいることを活かせるのかよく分からない…

そんな皆様に向けて半導体の製造プロセスを2日で学べる
実習を開講します！

未来のデジタル社会を作る半導体に実際に触れられる実習
になっておりますので是非ご参加ください！



●講座概要

実習期間：①令和5年3月11日(土)～12日(日)(2日間)

②令和5年3月25日(土)～26日(日)(2日間)

実習場所：東北大学西澤潤一記念研究センター

(宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 519-1176)

実習費用：無料(旅費、宿泊費等はご負担いただきます。)

参加人数：各回最大20名まで

お申込先：東北半導体・エレクトロニクスデザイン研究会事務局

TEL：022-221-4903(東北経済産業局 製造産業・情報政策課 今田、中井、平野)

E-MAIL：torihiki@joho-iwate.or.jp bzl-thk-handotai@meti.go.jp

(両アドレスに送付ください。)

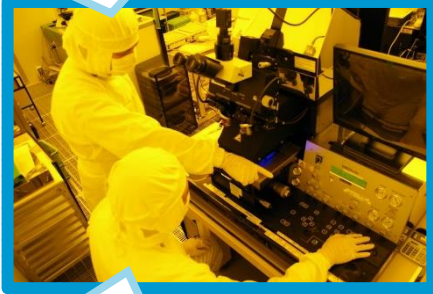


実習内容の詳細は裏面へ↘

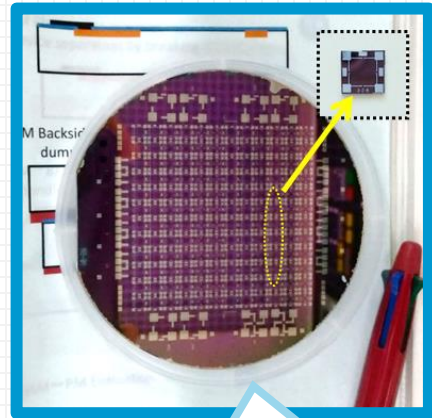
体験内容（ piezo抵抗型MEMSフォースセンサ IoTモジュール試作実習）

piezo抵抗型のMEMSフォースセンサのクリーンルーム内での一部プロセスやワイヤボンディング、PCB基板への実装、センサの動作テスト等を体験いただきます。

「前工程」と呼ばれるプロセスからスタート

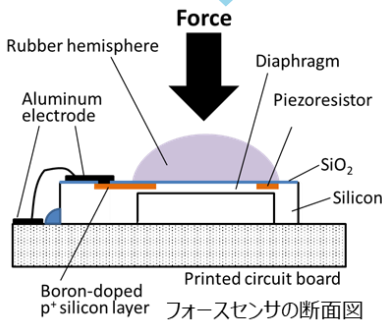


クリーンルームに入ってシリコンウエハにセンサの回路作成を体験できます！



回路が描かれたウエハです！
ひとつひとつ切り分けチップにします
※切り分け作業はカリキュラム外

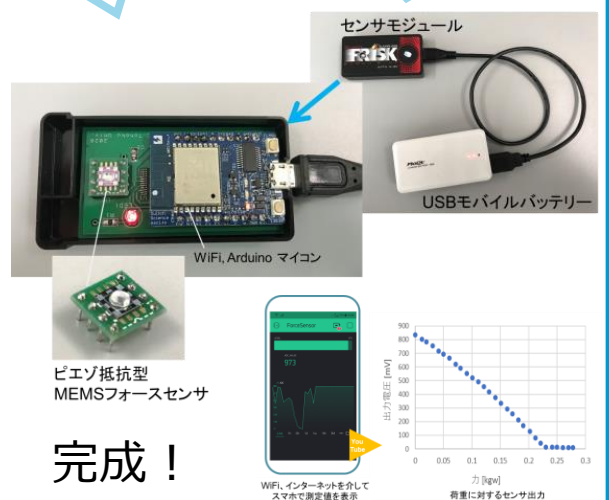
チップを基板に実装！
チップからセンサへ！



ここから「後工程」と呼ばれるプロセスに入ります！

センサをマイコンに組み込みモジュールにしていきます！

動作テストも行います！



スマホで出力を確認できます！

※人数の都合により後工程から体験してもらうこともございます。

●スケジュール

	Aグループ	Bグループ
1 日 目	10:00-12:00	オリエンテーション、ダイボンディング、ワイヤボンディング、PCB部品はんだ付け、ケース加工、マイコン書き込み、動作テスト
	13:00-15:00	
	15:00-17:00	
2 日 目	10:00-12:00	クリーンルーム内プロセス（フォトリソグラフィ、ドライエッチング、洗浄）
	13:00-15:00	
	15:00-17:00	